

# Semiconductor Equipment List

Product model		VF-690Q	VF-570Q	VF-530Q	VF-510Q	VF-300Q	VF-100Q	Model 200	RLA-310Q	RLA-120Q	SQ2-12-E	VFS-400Q	Model 205A	RLA-310Q-V	RLA-410Q-V	VF-530QHLP	VF-530QH	VF-300QHLP	VF-300QH	RLH Series
Wafer size	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	Up to φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	Other	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
Batch size (Maximum storage count / system)	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	1	1	100	-	-	1	1	100	75	-	50	200
	Up to φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	1	1	-	-	-	1	1	100	50	50	75	200
	Other (Rectangular substrate etc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	800	-	-	-	-	-	-	25
Transfer system	Wafer (substrate)	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-
	Cassette stocker	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP opener	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP stocker	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
System	Vertical Furnace	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	Horizontal Furnace	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Lamp Annealing System	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○
	Clean Oven System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Large Bore Vertical Furnace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
SIC Power Semiconductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	
Semiconductor	Annealing	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	Thermal oxidation	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD <small>(SiN, Poly-Si, Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTG</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Activated annealing			○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	Impurity diffusion	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Polyimide curing	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Gettering	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Sintering / Alloy	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIC Power Semiconductor	Activated annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
	Thermal oxidation	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Nitriding / Oxynitriding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
Contact annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
MEMS	Thermal oxidation	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	Thermal oxidation	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contact annealing	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV (Photovoltaic)	Impurity diffusion		-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Thermal oxidation	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Packaging	Polyimide cure	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
FPD	Curing (Polyimide curing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
	Activation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dehydrogenation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frit firing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Metal contact annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-